

中科英华高技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司（下称“中科英华”）第四届董事会第二十四次会议于 2005 年 3 月 16 日在本公司会议室召开。公司董事共 9 人，出席会议董事 8 人，王辉副董事长因出差委托谢利克董事代为行使表决权。2 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下相关事项：

一、 公司 2004 年配股延期一年的议案

2005 年 3 月 4 日，公司股东华创合润投资有限公司（持有本公司 5760 万法人股，占公司总股本的 17.24%，为本公司第二大股东，下称“华创合润”）以书面形式向公司董事会提议在 2005 年 3 月 28 日召开的公司 2004 年度股东大会上增加审议“公司 2004 年配股延期一年的议案”的临时提案。

提案理由：中科英华于 2004 年 4 月 25 日召开 2003 年年度股东大会上审议通过了中科英华 2004 年配股方案，有效期为一年。2004 年 9 月 10 日，中科英华配股申报材料已上报中国证券监督管理委员会，正在审核之中。

鉴于中科英华在 2004 年配股方案有效期内无法确定是否能够完成配股工作，为中科英华发展需要，华创合润提议将 2004 年公司配股方案延期一年。

本次董事会会议审核同意在 2004 年度股东大会上增加此临时提案，并审议通过如下相关事项：

（一）关于本次配股发行的议案

1、配股类型

人民币普通股；每股面值：人民币 1 元

2、本次配股发行的对象与配股比例及数量

（1）本次配股发行的对象

本次配股发行的对象为配股股权登记日在中国证券登记结算公司上海分公

司登记在册的本公司全体股东。

(2) 本次配股发行的配股比例及数量

本次配股发行拟以 2003 年末总股本 334,123,794 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东以现金方式配售，共可配售 100,237,138 股。其中：国有法人股可获配 11,843,648 股；境内其他法人股东可获配 47,090,585 股；社会公众股东可获配 41,302,905 股。国有法人股及法人股股东已书面承诺放弃本次配股。

3、本次配股发行的价格及定价依据

(1) 发行价格

本次配股价格拟定 5 - 7 元/股。

(2) 定价依据

- A、参考二级市场公司股票价格及市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
- B、配股价不低于公司 2004 年度经审计的每股净资产；
- C、募集资金投资项目的实际资金需求量；
- D、与承销商协商确定。

4、本次配股发行的认购方式

本次配股发行的股份应当仅以现金方式认购。

5、本次配股延期决议有效期

本次配股延期决议自公司 2004 年度股东大会审议通过后一年内有效。

6、公司配股资格

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和中国证监会《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的要求，董事会已将有关规定与公司实际情况逐一进行对照，对公司 2004 年增资配股资格进行了自查，认为公司符合上述法律、法规的规定，具备配股资格。

(二)关于本次配股募集资金用途、数量及项目可行性分析的议案

项目名称

- 1、联合铜箔（惠州）有限公司二期扩建（3,500 吨高档铜箔）项目
- 2、辐照加工中心技术改造项目
- 3、高性能热缩型电缆线束系统技术改造项目
- 4、新建年产 3,500 吨高档铜箔生产基地项目

(1) 本次配股募集资金计划用途、数量如下：

- A、联合铜箔（惠州）有限公司二期扩建（3,500 吨高档铜箔）项目

项目总投资为 20,518 万元，其中，固定资产投资 17,982 万元，铺底流动资

金 2,536 万元。项目总投资中,股东增资 16,540 万元,其中,本公司增资 12,405 万元,其余 4,135 万元由该公司其他股东增资。本公司增资的部分将全部使用本次募集资金。

本项目的可行性研究报告已经国家发展和改革委员会发改高技[2003]1953 号文批准。

B、辐照加工中心技术改造项目

本公司拟投资 4,459 万元在湖州中科英华新材料高科技有限公司进行辐照加工中心技术改造项目。其中,固定资产投资 2,959 万元,流动资金投资 1,500 万元。项目将全部使用本次募集资金。

本项目的可行性研究报告已经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]521 号文批准。

C、高性能热缩型电缆线束系统技术改造项目

本公司拟投资 4,368.3 万元进行高性能热缩型电缆线束系统技术改造项目。其中,利用原有资产 450 万元,新增投资 3,918.3 万元,其中新增固定资产投资 2,637.54 万元,流动资金 1,280.76 万元,项目新增投资部分将全部使用本次募集资金。

本项目的可行性研究报告已获吉林省经济贸易委员会吉经贸投资字[2003]151 号文批准。

D、新建年产 3,500 吨高档铜箔生产基地项目

本公司拟投资 22,322 万元在中科英华高技术股份有限公司宁波分公司进行新建年产 3,500 吨高档铜箔生产基地项目。其中,固定资产投资 19,769 万元,铺底流动资金 2,553 万元。项目将全部使用本次募集资金。

本项目的建议书已经国家发展和改革委员会发改工业[2003]837 号文批准。

本次配股募集资金将按上述项目排序进行投入,单个项目资金不足部分由公司贷款或以自有资金解决。

(2) 本次配股募集资金项目可行性分析如下:

A、联合铜箔(惠州)有限公司 3,500 吨高档铜箔扩建工程项目

铜箔产品是电子工业不可替代的基础材料,主要用于高档线路板、覆铜板和锂离子电池等领域,铜箔目前已经成为在电子整机产品中起到支撑、互连元器件作用的印制线路板(下称“PCB”)的关键材料,它被比喻为电子产品信号与电力传输、沟通的神经网络。随着 IT 产品技术的发展,促进了 PCB 朝着多层化、薄型化、高密度化、高速化方向发展,它也要求迈入了技术发展新时期的铜箔更

加具有高性能、高品质、高可靠性。

目前世界高档铜箔产品的生产技术、设备制造技术及市场份额被日本所垄断，全球主要铜箔供应商有三井金属、日本能源、古河电工、福田金属及日本电解等大公司。目前国内除了少数企业生产外，大部分依靠从日本、南韩和台湾等地进口。随着电子信息技术的迅速发展，全球对高档铜箔的需求与日俱增，市场前景十分广阔。

本项目的建设规模为在原年产 2,100 吨的基础上，新建年产 3,500 吨高档铜箔工程项目。主要建设内容为新建建筑面积 16,741 平方米，购建各类设备 108 台（套）。

本项目总投资 20,518 万元，项目建设期 2 年，预计投资收益率 39.72%，财务内部收益率 27.87%，投资回收期 5.45 年。

B、湖州中科英华新材料高科技有限公司辐照加工中心技术改造项目

辐照加工技术是继机械加工、热加工和化学加工之后的一种全新的材料加工高技术，可广泛应用于国民经济的有关领域。辐照加工产品广泛用于生产各部门和人们日常生活中。辐照加工技术在新技术革命、传统产业改造、新材料开发及微观加工等领域中发挥巨大作用。产品适应市场需求，市场前景广阔，竞争力强。

本项目以现有的辐照车间为基础，在湖州建设辐照加工中心，既满足了企业自身设备配套需要，同时可以满足湖州及周边地区的辐照加工的市场需求。

本项目的技改规模是增加两台电子加速器及配套设施，建设辐照加工中心，形成年辐照加工 4,500 吨热缩材料、电线电缆等其他材料的生产能力。其中企业辐照自产热缩管 1,000 吨，对外加工 3,500 吨。

本项目总投资 4,459 万元，建设期 2 年，预计内部收益率 21.1%，财务净现值 1,898.6 万元，投资回收期 6.3 年。

C、中科英华高技术股份有限公司高性能热缩型电缆线束系统技术改造项目

高性能热缩型电缆线束系统作为线束绝缘材料的主导产品之一，越来越广泛应用于汽车工业、航空、航天、装甲车辆、舰船、牵引机车、装载机械等领域，具有广阔的市场前景。同时，由于该类产品技术含量高，生产难度大，并主要以高性能、多品种取胜，存在较高的技术进入壁垒，国内仅有少数企业能够生产，国内市场主要依靠进口，存在较大的市场缺口。

本项目达产后年产 1 万套（500 吨）高性能热缩型电缆线束系统系列产品，不但可以满足国内市场客户需求，而且由于明显的性价比优势，可以替代部分进口产品。

本项目总投资 4368.3 万元，利用原有资产 450 万元，新增投资 3,918.3 万

元，建设期 1 年，预计内部收益率 33.52%，财务净现值 4,356 万元，投资回收期 5.17 年。

D、中科英华高技术股份有限公司宁波分公司年产 3,500 吨高档铜箔生产基地项目。

由于目前中科英华控股的联合铜箔产业化规模尚小，无法满足市场需求。中国铜箔市场主要集中在长江、珠江三角洲等地区，而宁波正位于长江三角洲，其地理位置优越、交通便利，并且有较好的工业基础与良好的投资环境。因此，中科英华拟在宁波新建 3500 吨高档铜箔生产基地，以满足迅速增长的市场需求，同时为宁波的经济发展做出一定的贡献。

本项目的建设规模为年产 10-18 微米高档铜箔 3,500 吨。主要建设内容为新建建筑面积 16,759 平方米，购建各类设备 110 台（套）。

本项目总投资 22,322 万元，项目建设期 2 年，预计投资收益率 35.22%，财务内部收益率 21.01%，投资回收期 6.19 年。

(三)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

为保证本次配股工作的连续性，故公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜，具体授权内容如下：

- 1、全权办理本次配股的申报事项；
- 2、根据公司股东大会审议通过的本次配股议案，在本次配股的有效期内视市场情况及中国证券监督管理委员会的相关政策规定，与主承销商协商决定本次配股的发行时间，发行价格等；
- 3、在本次配股完成后，办理工商变更登记、《公司章程》有关条款的修改等相关事项；
- 4、签署与本次配股有关的各项文件及投资项目运作过程中重大合同；
- 5、根据国家相关规定办理其他与本次配股相关的事宜。

上述配股延期的相关议案将作为临时提案提交 2004 年度股东大会审议。根据规定，股东大会将对上述一、（一）1 - 6 项、（二）1 - 4 项、（三）共 12 项议案进行逐项表决，该 12 项议案除了需参加表决的全体股东所持有的表决权的半数以上通过外，还需经参加表决的流通股股东所持有的表决权的半数以上通过。中科英华 2004 年年度股东大会通知详见 2005 年 2 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过若公司 2004 年增资配股事宜获得中国证券监督管理委员会的核准，公司控股子公司中科英华（香港）商贸有限公司的全资子公司 BACHFIELD LIMITED 公司将对公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司增资 500 万美元的议案

公司 2004 年增资配股项目之一的“联合铜箔（惠州）有限公司（下称“联合铜箔”）二期扩建（3,500 吨高档铜箔）项目”为联合铜箔股东对其增资 2000 万美元，其中，中科英华增资 1500 万美元，其余 500 万美元由该公司其他股东增资，联合铜箔原股东 HopeBest Investment Ltd 公司于 2004 年 8 月已承诺若中科英华 2004 年配股事宜获得核准将对联合铜箔增资 500 万美元。

鉴于公司控股子公司中科英华（香港）商贸有限公司的全资子公司 BACHFIELD LIMITED 公司已于 2004 年 12 月收购了 HopeBest Investment Ltd 公司持有的联合铜箔的股权，因此 BACHFIELD LIMITED 公司承诺若中科英华配股成功，将对联合铜箔增资 500 万美元。

三、授权湖州中科英华新材料高科技发展有限公司（公司控股子公司，以下简称“湖州中科英华”）以其现址房屋、部份设备、土地资产对外投资并全权管理及处置上述资产的议案

公司控股子公司湖州中科英华已经另行择址建造辐照产业基地，建成后现址将不再进行生产经营活动，为盘活资产，提高资产的使用效率，公司授权湖州中科英华以现址房屋、部份设备、土地资产以 1300 万元的价格对外投资，并授权其管理及处置上述资产。

该部分资产的帐面值为 12,961,049.13 元，经湖州汇丰联合会计师事务所评估，上述资产评估值为 13,008,092.00 元。汇丰联合会计师事务所对此出具了汇丰资评报字(2005)012 号评估报告。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2005 年 3 月 16 日